

Compression Molding System

Model CPM1080-HP



**New compression molding system achieving high precision
and high productivity for WLP/PLP molding processes**



WLP・PLP成形プロセスの 高精度・高生産性を実現する 新たなコンプレッションモールド装置

- HBM/2.5D/3D/Chipletおよび FOWLP/PLP などの先端パッケージに最適
- 独自開発のコンプレッション技術を核としたウェハレベルモールド、パネルレベルモールドを実現
- 薄厚成形やMUF充填に有効な独自の均一樹脂散布・パターンディスペンスに対応
- モールド厚み平坦度・到達真空度を向上し、より高品質な生産を実現
- プリカット方式を採用。1成形あたりのフィルム使用量を約25%削減(当社比)



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
モデル			—	CPM1080-HP			
ワークタイプ			—	パネル・ウェハ			
ワークサイズ	パネル		mm	□150—320mm			
	ウェハ		mm	φ 320 (Max.)			
樹脂			—	顆粒・液状			
マシンタイム			sec	Approximately 65			
外形寸法	プレス数		module	1	2	3	4
	幅		mm	5,490	6,170	6,850	7,530
	奥行き		mm	2,168	2,168	2,168	2,168
	高さ	顆粒樹脂仕様	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
		液状樹脂仕様	mm	2,170	2,170	2,170	2,170
重量			ton	10.2	13.8	17.4	21.0
成形取り数			workpiece	1	2	3	4
マガジンスペース			—	Panel：Input／Output 2 cassette each Wafer：2 loadport			
クランプ出力			kN／(tf)	98.0—784.0／10.0—80.0			
クランプ速度			mm／sec	100 (Max.)			
リリースフィルム幅			mm	440 (Max.)			
オプション	チップ数カウント		—	○			
	パッケージ外観検査		—	○			
	パッケージ厚み測定		—	○			
	アフターキュア		—	○			
	フィルムハンドラー		—	○			
	基板プレヒータ		—	○			

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先

TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.韓国
TOWA Korea Co., Ltd.シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.マレーシア
TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITEDフィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITEDドイツ
TOWA Europe GmbHオランダ
TOWA Europe B.V.アメリカ
TOWA USA Corporation